

MicroBeam连接器和电缆组件

MicroBeam连接器和电缆组件专为高密度、近芯片应用场合设计，是扁平且高性能的连接解决方案。它们支持高达112Gbps的传输速率，具备卓越的信号完整性（SI），并提供12或16个差分对（DP）连接。其紧凑的设计使整体插配高度降至不到7.00毫米，从而减少了自身对其它组件的干扰，同时优化了空气流动和热管理。

优点和特点

优化热管理

小于7.00毫米的扁平插配高度使导体能够位于散热器组件下方，最大限度地改善空气流通，进而提高冷却效果。

确保性能稳定

该连接器采用坚固的设计，配有金属壳体和盖板，可承受较大机械力，因此不宜损坏且连接性能稳定。

简化装配和维护操作

该连接器的设计简洁直观，装配人员无需使用工具或参加专业培训即可轻松插入连接头、完成配接和解配操作，从而有效减少系统停机时间和配接错误。

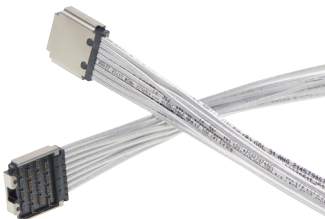
路数	12或16个差分线对
数据速率	高达112Gbps
插配高度	<7.00毫米
电流（最大值）	每引脚0.75安
电缆线规	31 AWG双芯
工作温度	-40至+85摄氏度

提供高数据速率和出色的信号完整性

由于采用了支持优化信号完整性的twinax电缆，数据速率可达112Gbps，用户可通过BiPass电缆连接来满足市场需求。

支持高密度架构

由于采用小型化设计，设计人员可以在芯片周围放置多个连接器，从而提供更多的高速通道。



应用场合

网络

- 以太网交换机
- AI硬件
- 与面板连接的高速布线



以太网交换机



人工智能硬件



与面板连接的高速布线

MicroBeam连接器和电缆组件

规格参数

参考信息

零部件系列：插座 - 219030

电缆组件 - 221633221635

包装：卷带（插座）

设计计量单位：毫米

是否符合RoHS标准：是

是否无卤素：是

电气参数

电压（最大值）：29.9伏有效值

电流（最大值）：每个引脚0.75安

接触电阻（最大值）：20毫欧姆（初始值）

绝缘耐压：300伏交流有效值

绝缘电阻：1000兆欧

阻抗：92.5欧姆

环境参数

温升（最大值）：85摄氏度（0.75安，
各信号触点串联）

温度与寿命：EIA-364-17 方法A，第4条

热冲击：EIA-364-32 方法A，第1条

机械振动：EIA-364-28，第7条

机械冲击：EIA-364-27，A条

循环温度和湿度：EIA-364-31，方法4

混合流动气体：EIA-364-65 IIA级

热干扰：EIA-364-110，A条、持续时间A

粉尘：EIA-364-91

机械参数

插配力（最大值）：50牛（插座盖关闭力）

拔脱力（最大值）：30牛（插座盖打开力）

可插拔次数（最小值）：100次

物理参数

塑壳：LCP

座片：LCP

板端底座电缆盖：不锈钢

插座盖和侧护板：不锈钢

板端底座电缆保护盖：透明PET

触点端子：铜合金

电镀：

接触部位 - 最小值0.76微米，镀镍后镀金

插座表面贴装尾部部位 - 镀镍后镀超薄金

插座侧护板 - 可焊接镍

电缆：31 AWG双芯

工作温度：-40至+85摄氏度